一、基本情况

姓名	刘培生	性别	男	出生年月	197104
来校工作年月	200808	来院工作年月	2019.08	联系电话	15996666018
现聘专业技术职务及聘任时间	教授　2021.7.17				
上轮聘期定档情况	专任教师岗　四　档				

二、考核情况

考核年度	2023 年	2024 年	2025 年
年度考核情况	优秀	合格	合格
师德师风情况	优秀	优秀	优秀
教学质量考核情况	良好	良好	良好

三、教学类业绩

时间	工作量	学部工作量要求	完成比例	审核结论
2023	909.55	416	218.6%	
2024	985	416	236.8%	
2025	900.25	416	216.4%	
是否完成学校和学院下达的工作任务				是

四、成果类业绩

获得时间	奖励类别	奖励名称	备案部门
2023	5 级论文	Reliability Analysis of Flip-Chip Packaging GaN Chip with Nano-Silver Solder BUMP	学校科技处
2023	5 级论文	Effect of Solder Layer Void Damage on the Temperature of IGBT Modules	学校科技处
2024	4 级论文	3D package thermal analysis and thermal optimization	学校科技处
2025	5 级论文	Research Progress on Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT) Modules	学院科技处
2025	4 级论文	Reliability Study of Critical Structural Redistribution Layers in Advanced Packaging: A Review	学校科技处
2025	4 级论文	Mitigating thermal cycling-induced failures in SiC-based hybrid IGBT modules: optimization of solder and reliability enhancements	学校科技处
2025	5 级论文	Optimizing Signal Integrity in 3-D Sensor Packaging Using Embedded Inverted T-Slot Shielding Structures	学校科技处
2025	5 级论文	Enhancing the thermomechanical reliability of CSP-LEDs for high-stability photonic sensing applications	学校科技处

五、公共服务类业绩

时间	主要工作内容
2023-2025	集成电路专业负责人
2023-2025	集成电路专业班主任（集 251、集 252、集 221-223）
2024-2025	省品牌专业负责人